

证券代码：688120

证券简称：华海清科

## 华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	网络远程参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的投资者	
时间	2024 年 9 月 3 日	
地点	全景路演网站（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）	
上市公司接待人员姓名	董事长、首席科学家 独立董事 董事、副总经理、董事会秘书 财务总监	路新春 李全 王同庆 王怀需
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1：请问公司 2024 年上半年订单情况如何？后续订单展望怎样？</b></p> <p><b>A：</b>尊敬的投资者您好，公司 2024 年上半年新签订单较为饱满，CMP 装备、晶圆再生等订单均有不错增幅，减薄装备已取得多个领域头部企业的批量订单，公司正按照客户及订单时间要求进行机台交付。公司将积极跟进客户的扩产计划，并坚持以市场方向和客户需求为导向，持续加大自主研发力度，持续推进新产品新工艺开发，进一步开拓市场和客户，争取更多订单和市场份额。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>Q2：请问先进封装技术的快速发展对公司有何影响？</b></p> <p><b>A：</b>尊敬的投资者您好，随着 AI、高性能计算等领域的快速发展，对芯片性能和功耗的要求不断提高，通过内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装的 Chiplet 和基于 2.5D/3D 封装技术将 DRAM Die 垂直堆叠的高带宽存储器</p>	

(HBM) 等先进封装技术和工艺成为未来发展的重要方向。公司主打产品 CMP 装备、减薄装备、清洗装备、划切装备均是芯片堆叠技术、先进封装技术的关键核心装备，将获得更加广泛的应用，也是公司未来长期高速发展的重要机遇。感谢您对公司的关注。

**Q3: 请问公司投资建设上海集成电路装备研发制造基地的原因，相关资金如何解决？**

**A:** 尊敬的投资者您好，上海集成电路装备研发制造基地项目将开拓长三角及周边地区的重要客户，提高公司的辐射范围，并根据客户需求就近开展集成电路专用设备的研发、生产，将进一步扩大公司生产经营规模和提高技术研发实力。本项目总投资不超过 169,781 万元，将根据项目建设进展分批投入，资金来源于公司及全资子公司华海清科上海的自有和自筹资金。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所网站的相关公告。感谢您对公司的关注。

**Q4: 请问公司回购股份进展如何？**

**A:** 尊敬的投资者您好，截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 380,260 股，支付的资金总额为人民币 5,791.67 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站的相关公告。感谢您对公司的关注。

**Q5: 公司推出的减薄产品有何进展？**

**A:** 尊敬的投资者您好，公司积极把握 Chiplet 和 HBM 等先进封装领域的发展机遇，持续推进减薄装备的研发验证工作，12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile - GP300 已取得多个

	<p>领域头部企业的批量订单，获得客户的高度认可，预计部分机台将在 2024 年下半年实现验收；12 英寸晶圆减薄贴膜一体机 Versatile - GM300 已发往国内头部封测企业进行验证。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>Q6：华海清科毛利率及净利率一直不错，后续能维持吗？</b></p> <p><b>A：</b>尊敬的投资者您好，公司将通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等管理措施保持公司毛利率和净利率在一个相对稳定的水平。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>Q7：请问公司的订单确认节奏有变化吗？</b></p> <p><b>A：</b>尊敬的投资者您好，公司按照客户验收单确认收入，各季度验收规模根据客户验收进展变动，订单确认节奏没有显著变化。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 3 日